



**2023年度 第2四半期
決算説明会
イビデン株式会社 (4062)**

2023年10月27日

このプレゼンテーション資料には、2023年10月26日現在の将来に

関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。

世界経済・競合状況・為替変動等にかかわるリスクや不確定要因

により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性があります。

2023年度上半期 実績



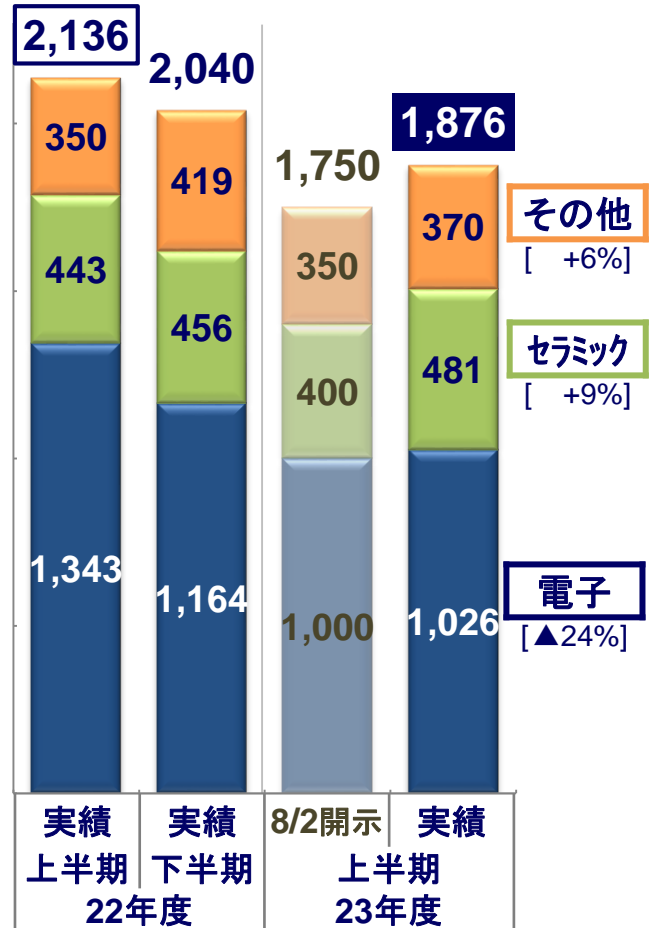
2023年度(上半期) 売上高・営業利益・純利益 実績 IBIDEN

売上高

[]は
前年同期比

前年同期比
▲12.1%

(億円)



その他
[+6%]

セラミック
[+9%]

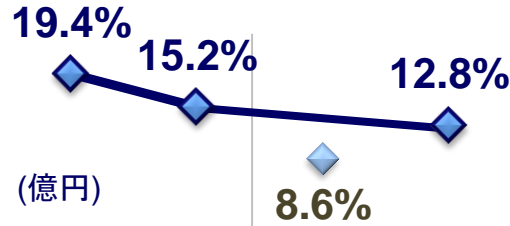
電子
[▲24%]

営業利益

[]は
前年同期比

営業利益率

前年同期比
▲41.9%



(億円)

414

21
39

355

310

35
23

252

150

25
35

90

241

23
58

160

その他
[+11%]

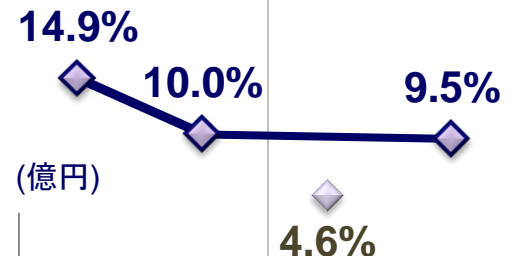
セラミック
[+49%]

電子
[▲55%]

純利益

純利益率

前年同期比
▲43.8%



(億円)

318

204

80

179

318

204

80

179

129	138	130	138	為替(ドル)
135	142	140	150	為替(ユーロ)

2023年度 見通し

2023年度(通期) 売上高・営業利益・純利益 見通し

売上高

[]は
22年度比

22年度比
▲9.0%

営業利益

[]は
22年度比

22年度比
▲32.3%

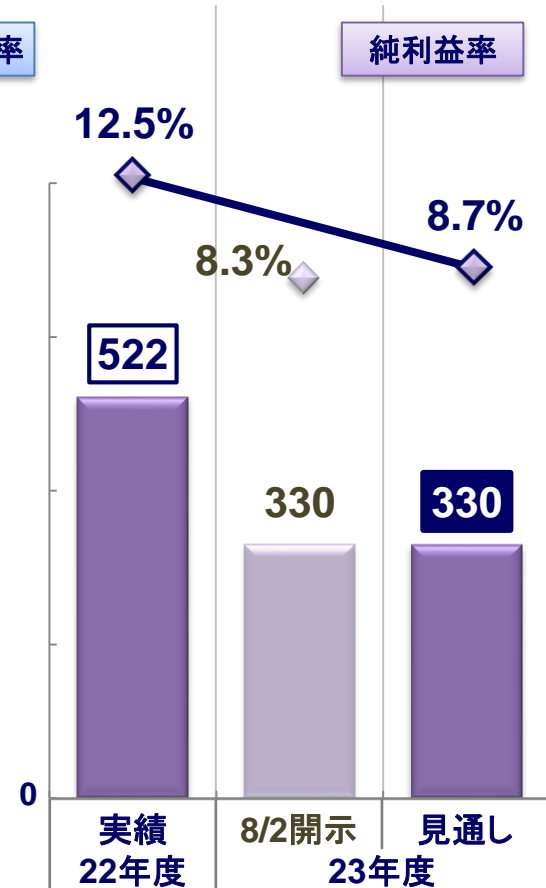
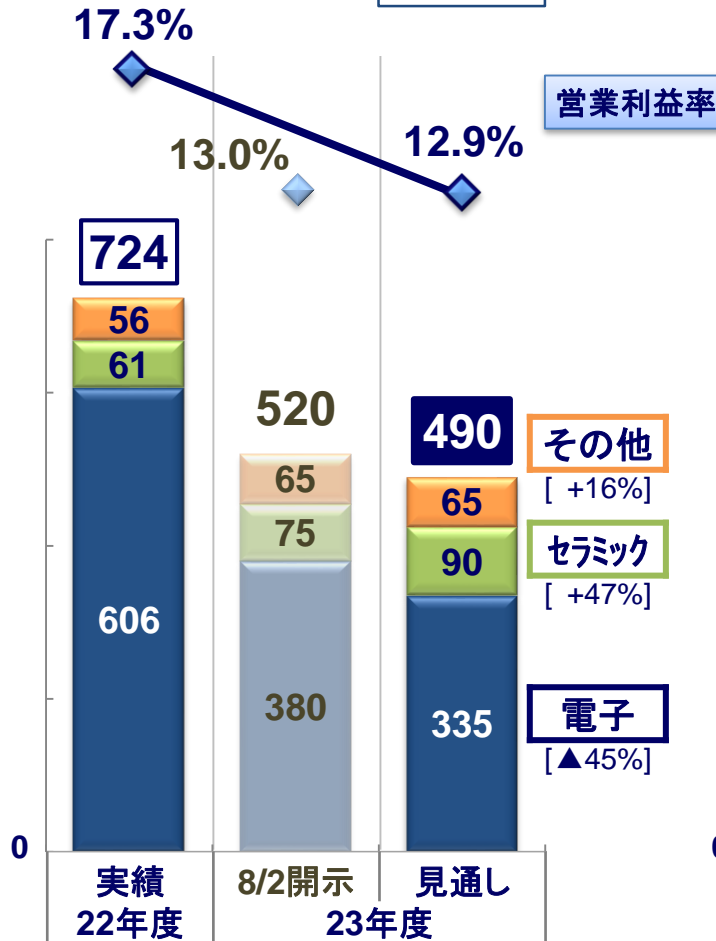
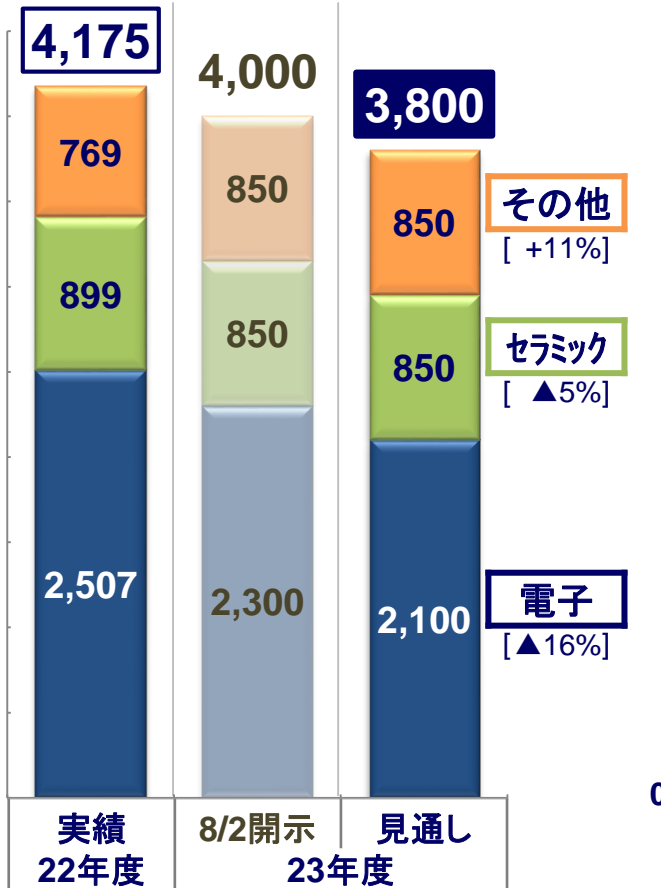
純利益

22年度比
▲36.8%

(億円)

(億円)

(億円)



133	130	140	為替(ドル)
139	140	150	為替(ユーロ)

市場見通しと 当社事業展望

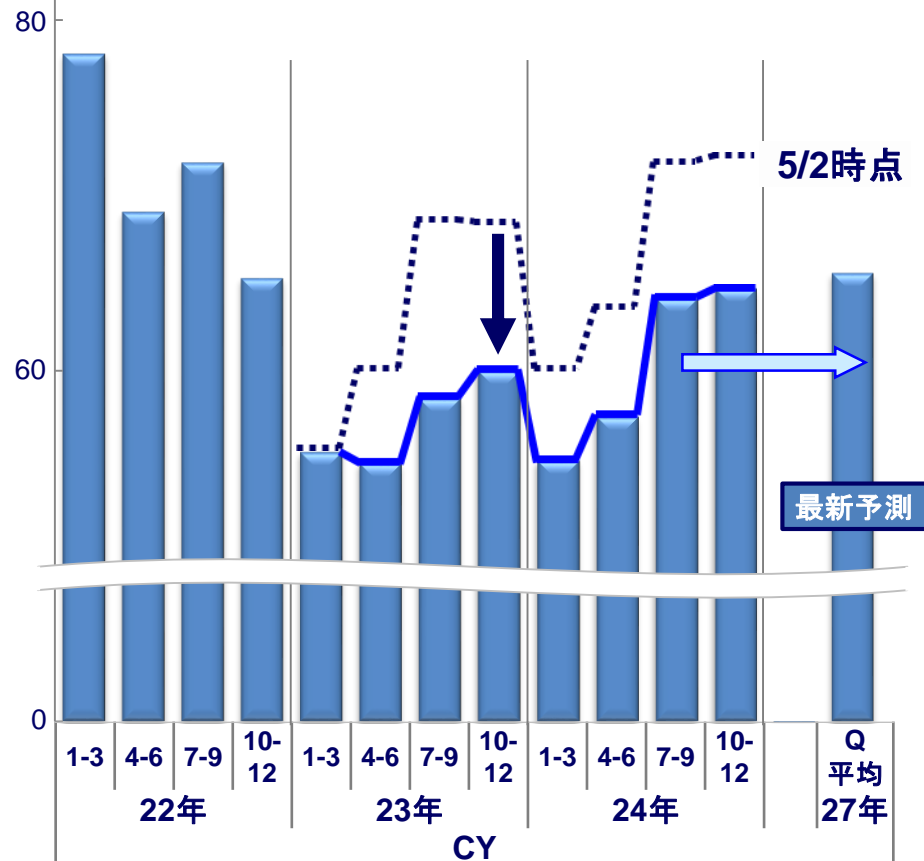
電子市場の動向と変化

- パソコン市場は23年前半に底打ちするも、22年水準への回復は期待できず
- サーバー市場は回復基調にあるも期初想定よりも鈍化、24年前半から緩やかに回復

パソコン市場

(外部調査会社の情報を基に推定)

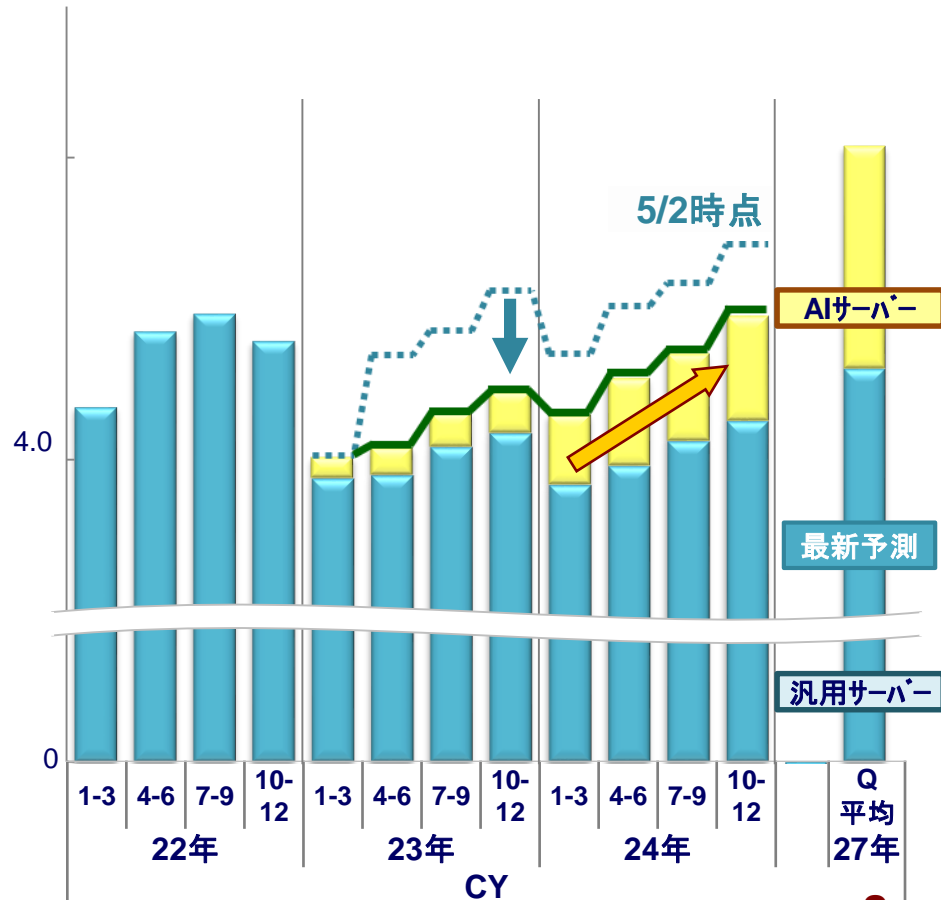
(百万台)



サーバー(汎用+AI)市場

(外部調査会社の情報を基に推定)

(百万台)



ICパッケージ基板の需要見通しと投資計画

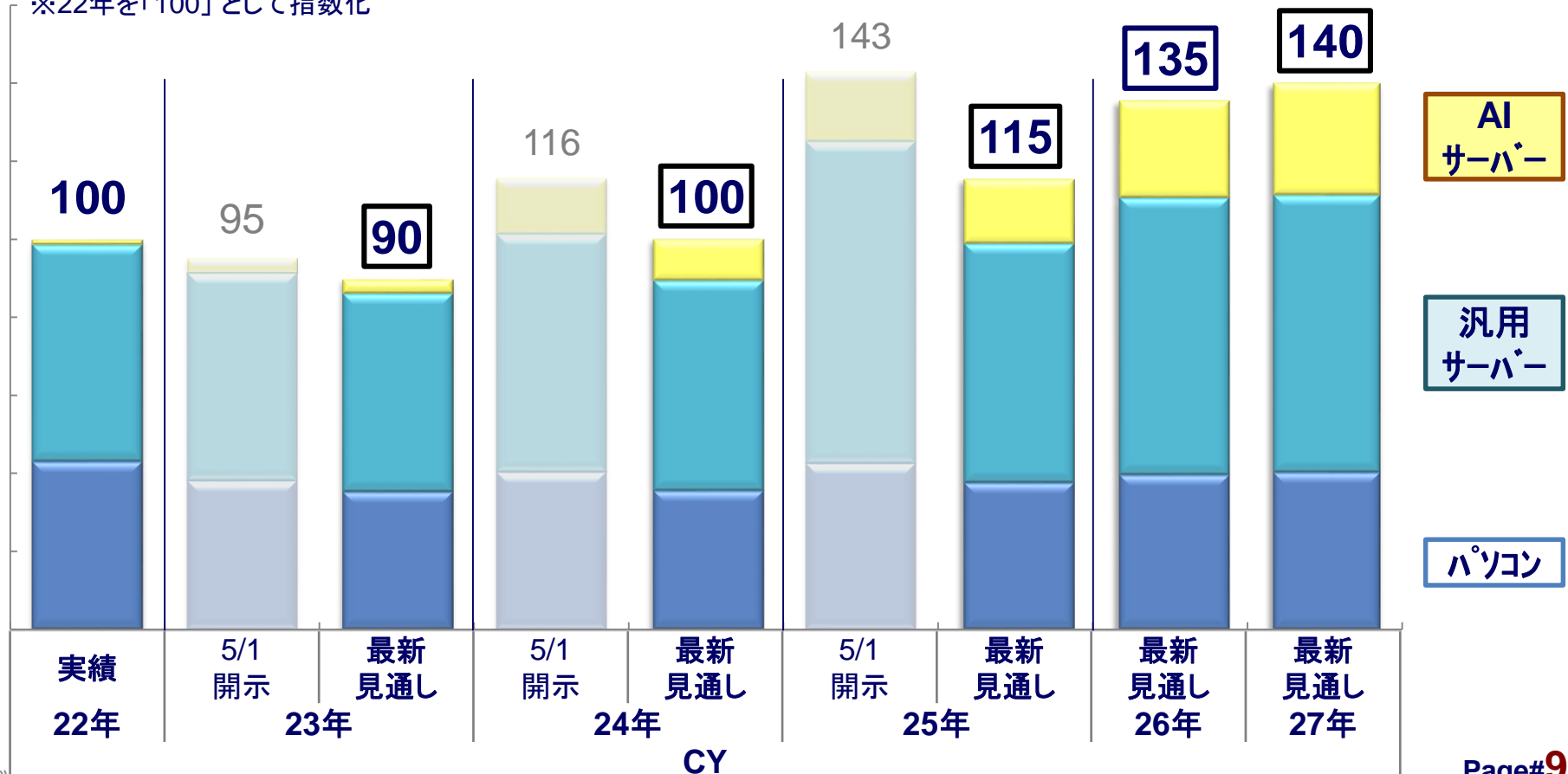
- 大型・高機能ICパッケージ基板の需要変化を受け、大野工場の立上げを先行する
- 既存工場を含め、柔軟かつ必要十分な生産能力を構築し、顧客・用途の多様化と生成AIを軸とした中長期の需要拡大に対応する

SAP*需要(面積)

(顧客情報等を基に推定)

※SAP : Semi Additive Process

※22年を「100」として指数化



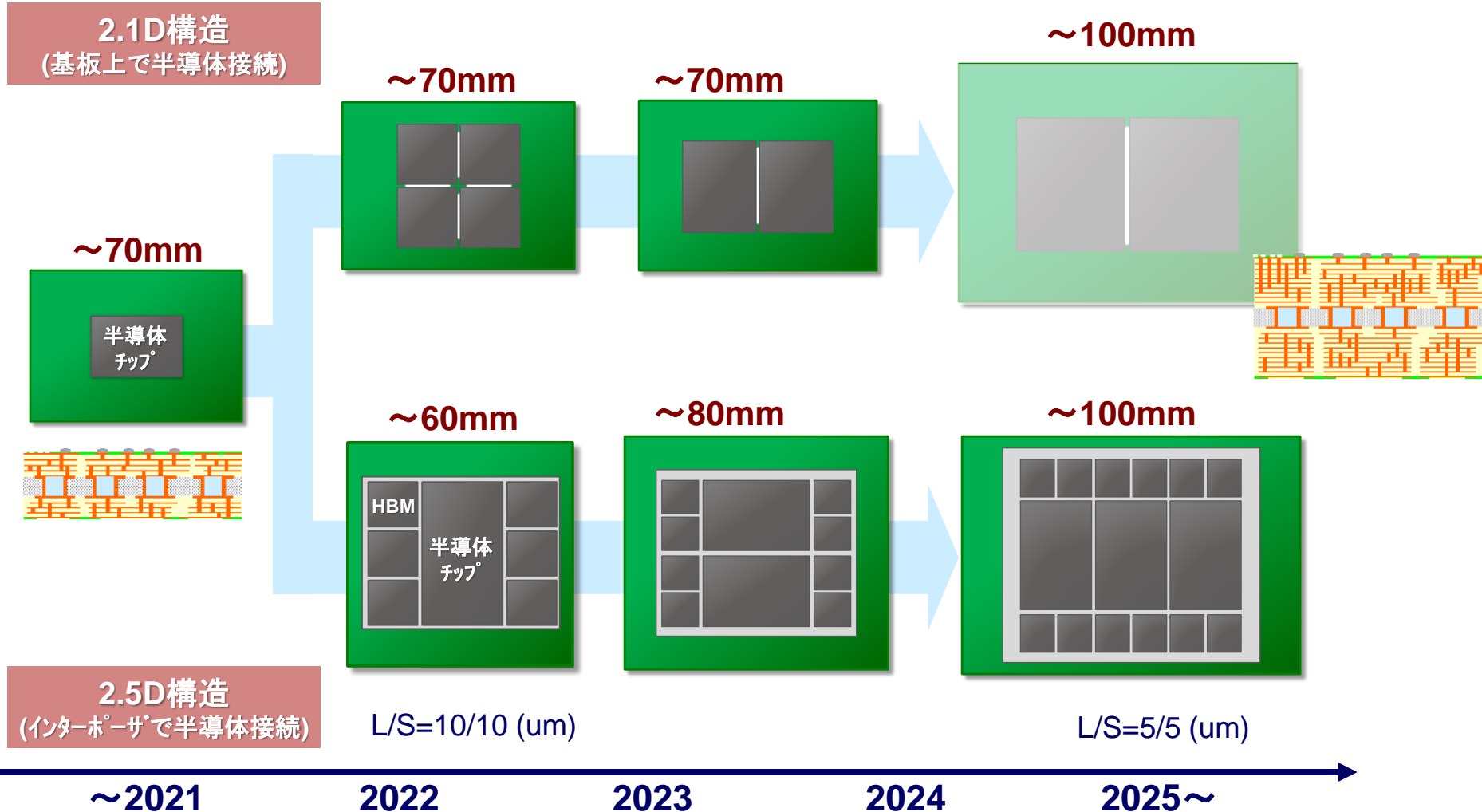
AI
サーバー

汎用
サーバー

パソコン

ICパッケージ基板の技術変化

- データ処理能力の高度化と省エネ化ニーズにより、半導体の高機能化が見込まれる
- ICパッケージ基板の大型化・微細化・高多層化・3D化(付加価値の向上)は進展、多様な顧客と中長期の技術ロードマップを共有・必要となる要素技術を先行開発する



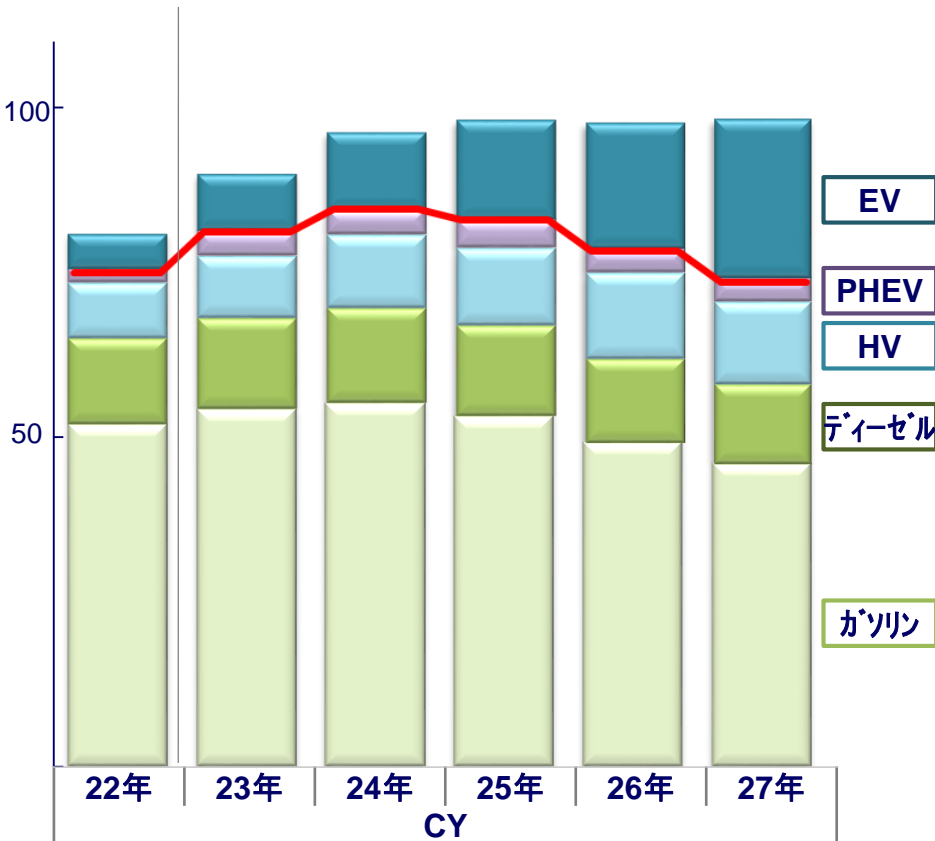
セラミック市場の動向と変化

- 先進国・乗用車市場を中心に電動化は加速するも、内燃機関搭載車は一定のシェアを維持
- 自動車パワートレインの電動化に伴い、Si/SiCパワー半導体市場が拡大

パワートレイン市場

(外部調査会社の情報を基に推定)

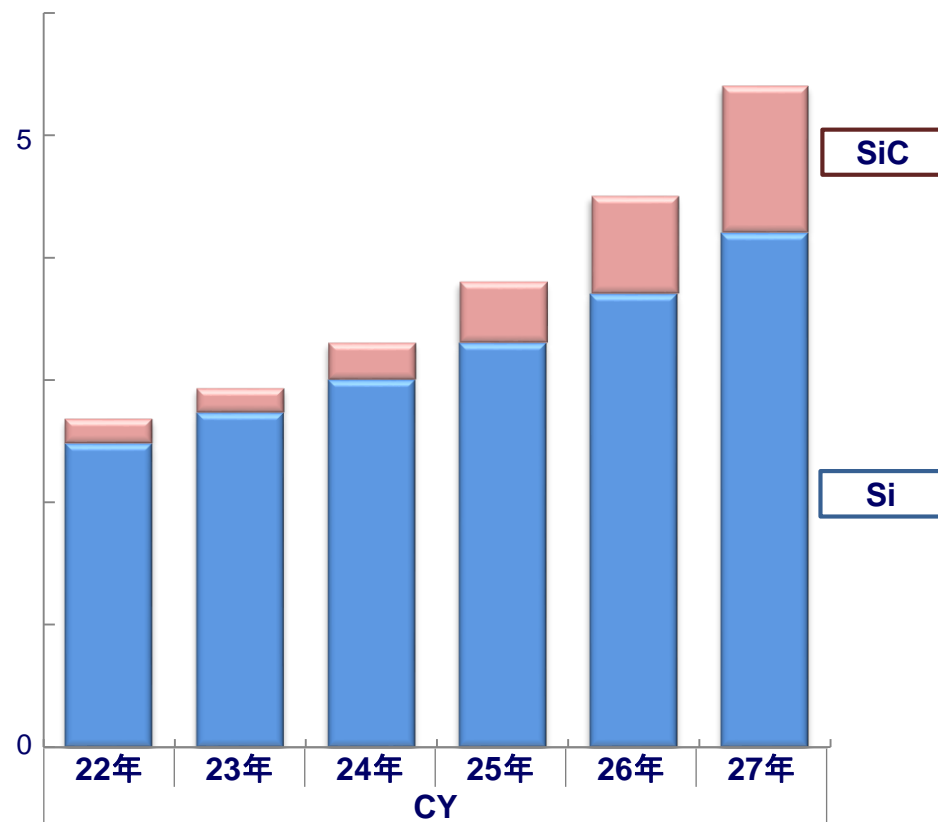
(百万台)



パワー半導体市場

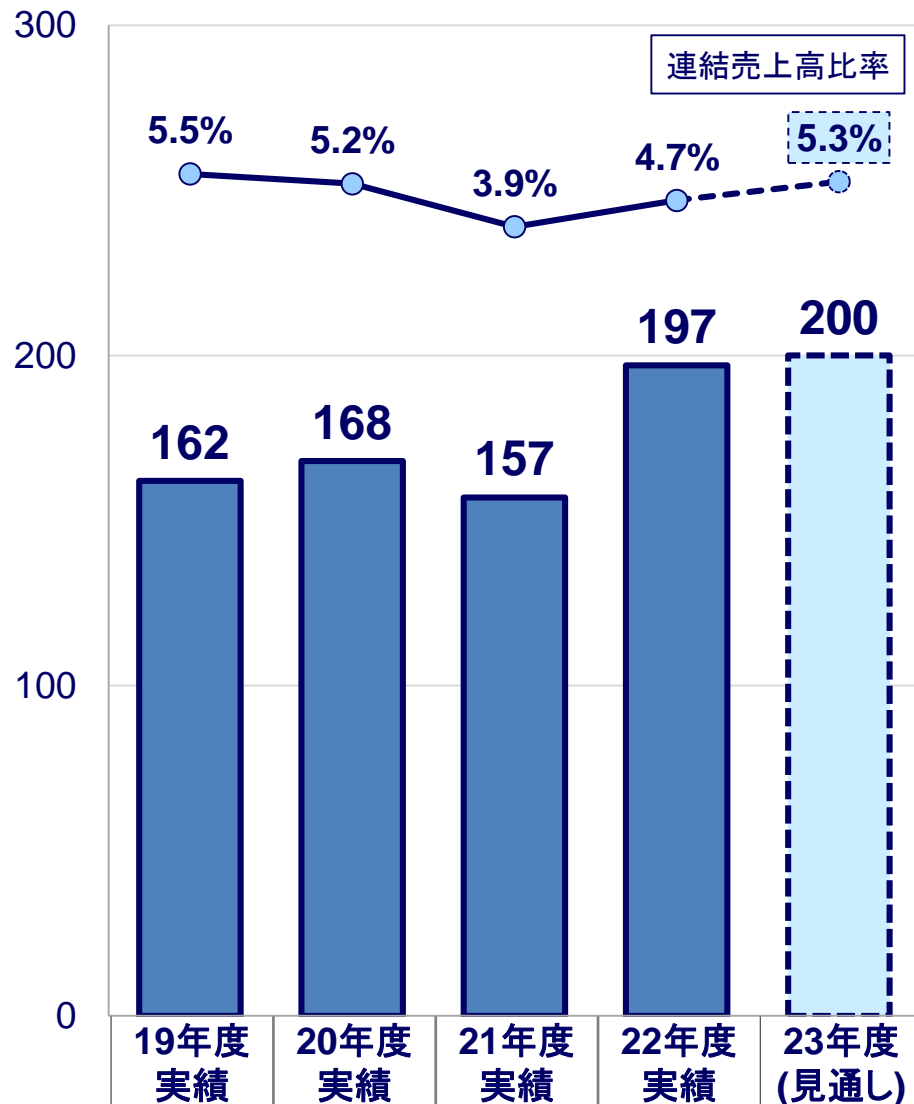
(外部調査会社の情報を基に推定)

(兆円)



次の成長に向けた研究開発活動

研究開発費の推移(実績・計画)

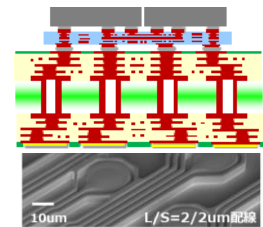


当社・技術開発本部の開発領域

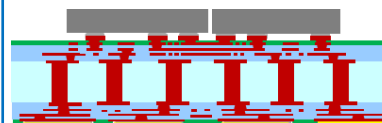
エレクトロニクス領域

- 次世代3Dパッケージ
- ガラスコア基板
- 光デバイス

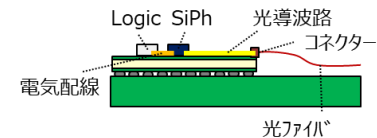
【次世代PKG】



【ガラスコア基板】



【光デバイス】



NEV領域

- NEV向け部材
 - LiB安全部材
 - 耐熱断熱材
 - 耐熱絶縁部材



新領域

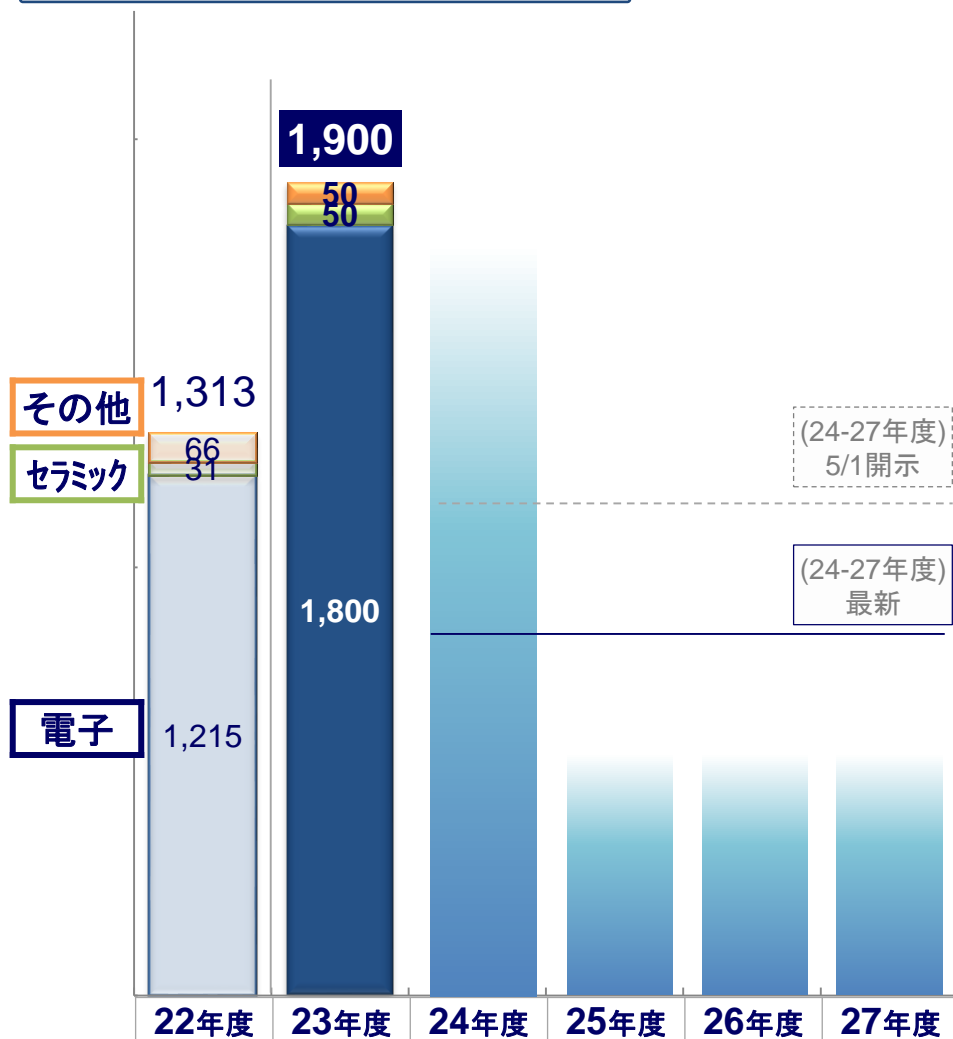
- 植物活性化材 (LEAF ENERGY)
- CO₂固定化技術



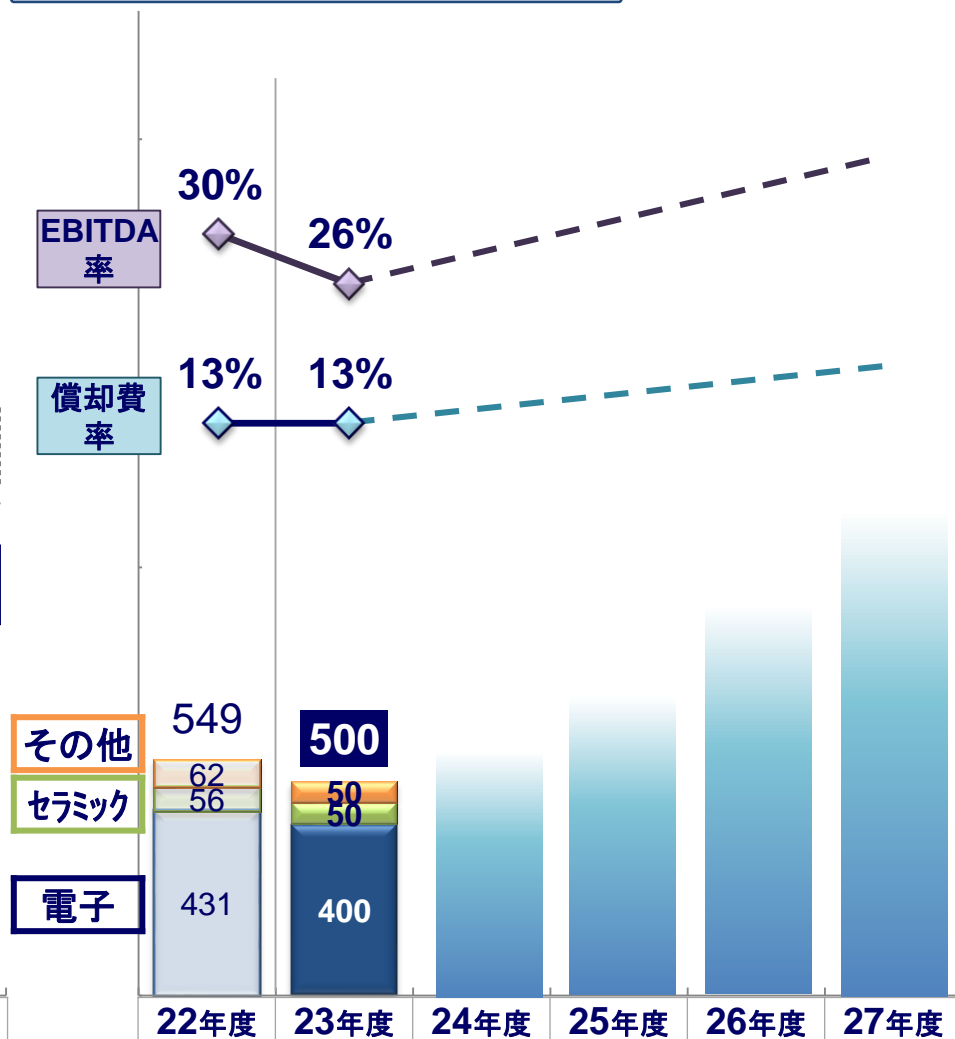
中期連結 見通し

設備投資(検収)額・減価償却費の計画

設備投資額 (億円)



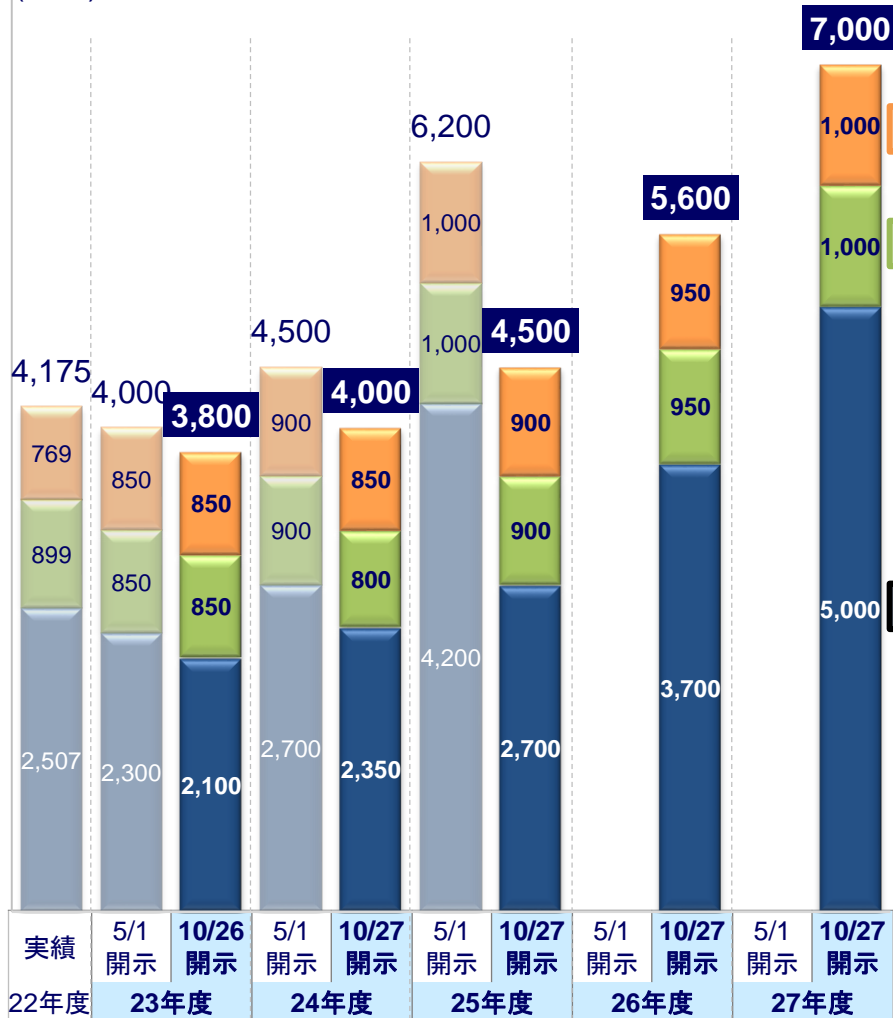
減価償却費 (億円)



中期業績見通し

売上高

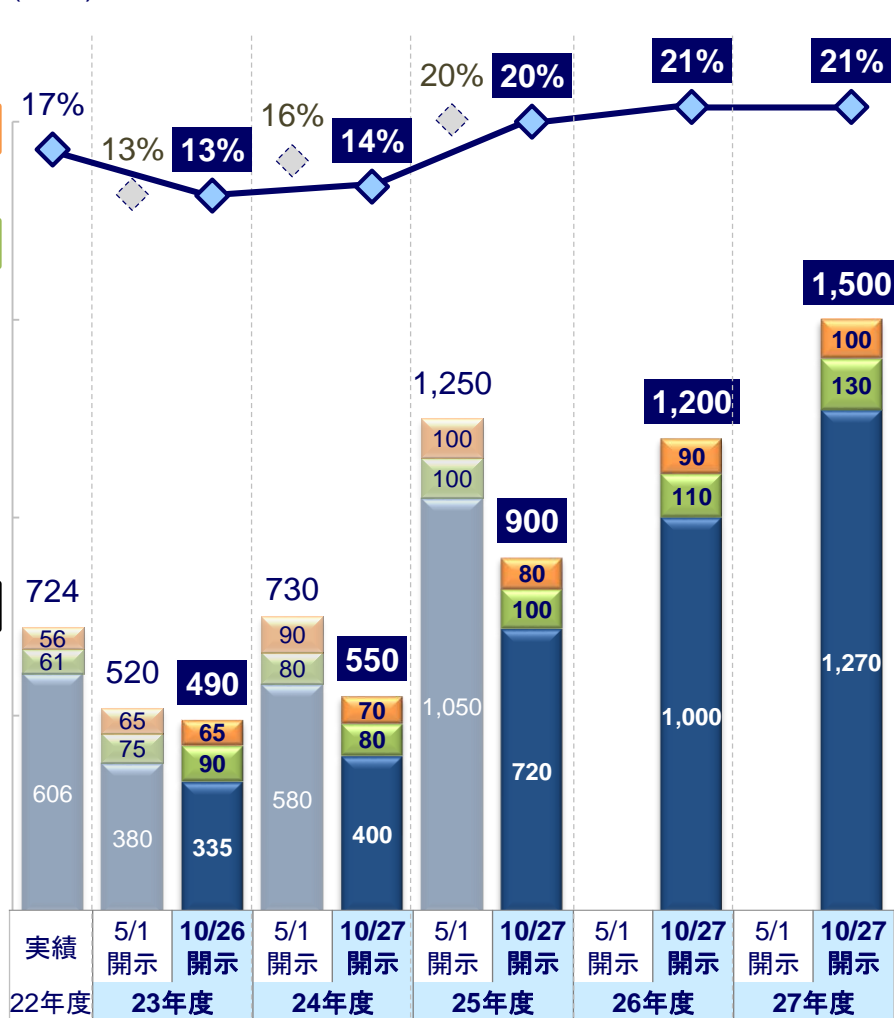
(億円)



営業利益

営業利益率

(億円)

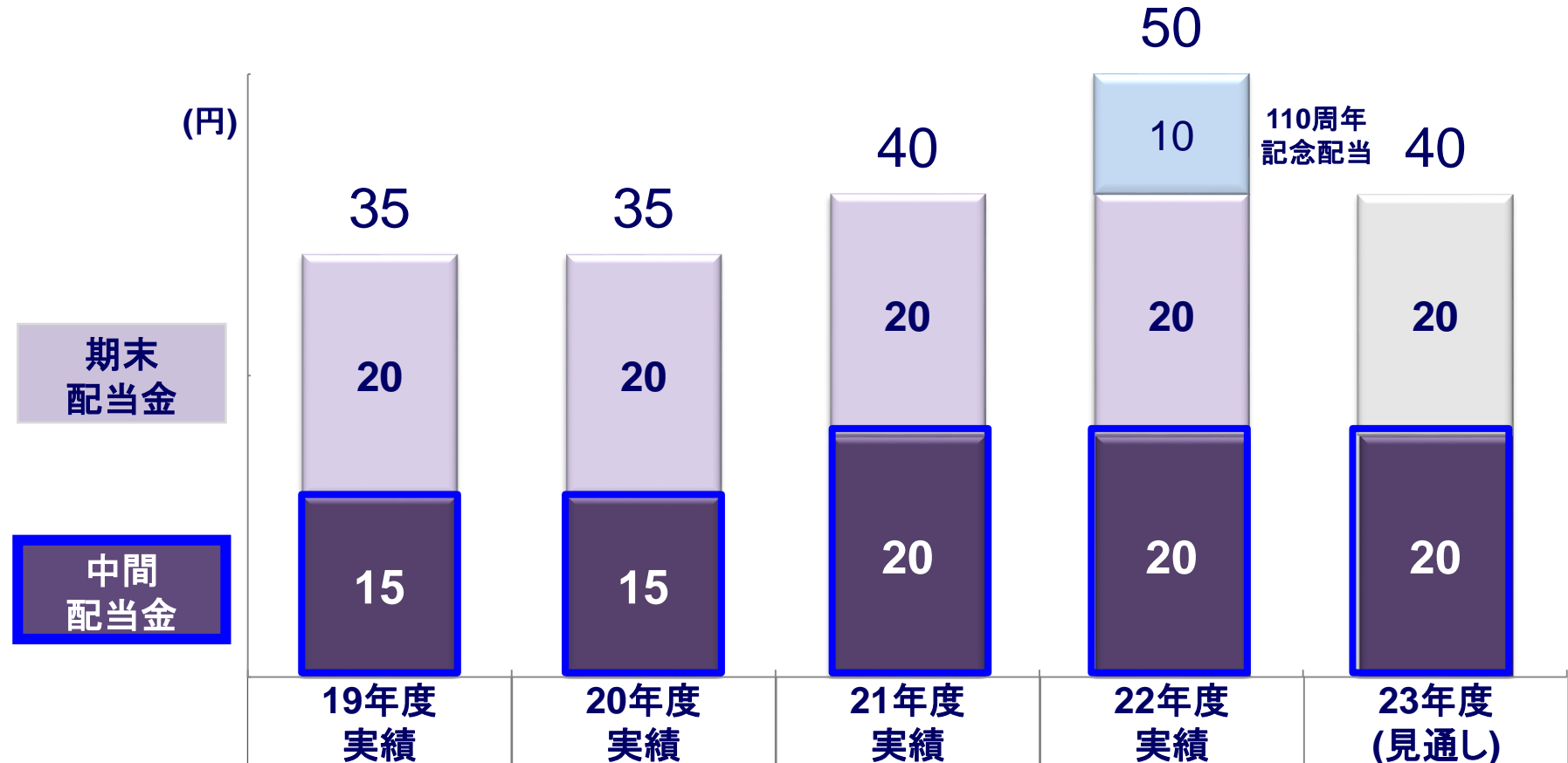


株主還元

資本配分と株主還元

- 足もとの市況変化に確実に対応しつつ、中長期の需要拡大に備え、ICパッケージ基板の大型投資を継続実施する
- 株主還元は、安定配当を継続する

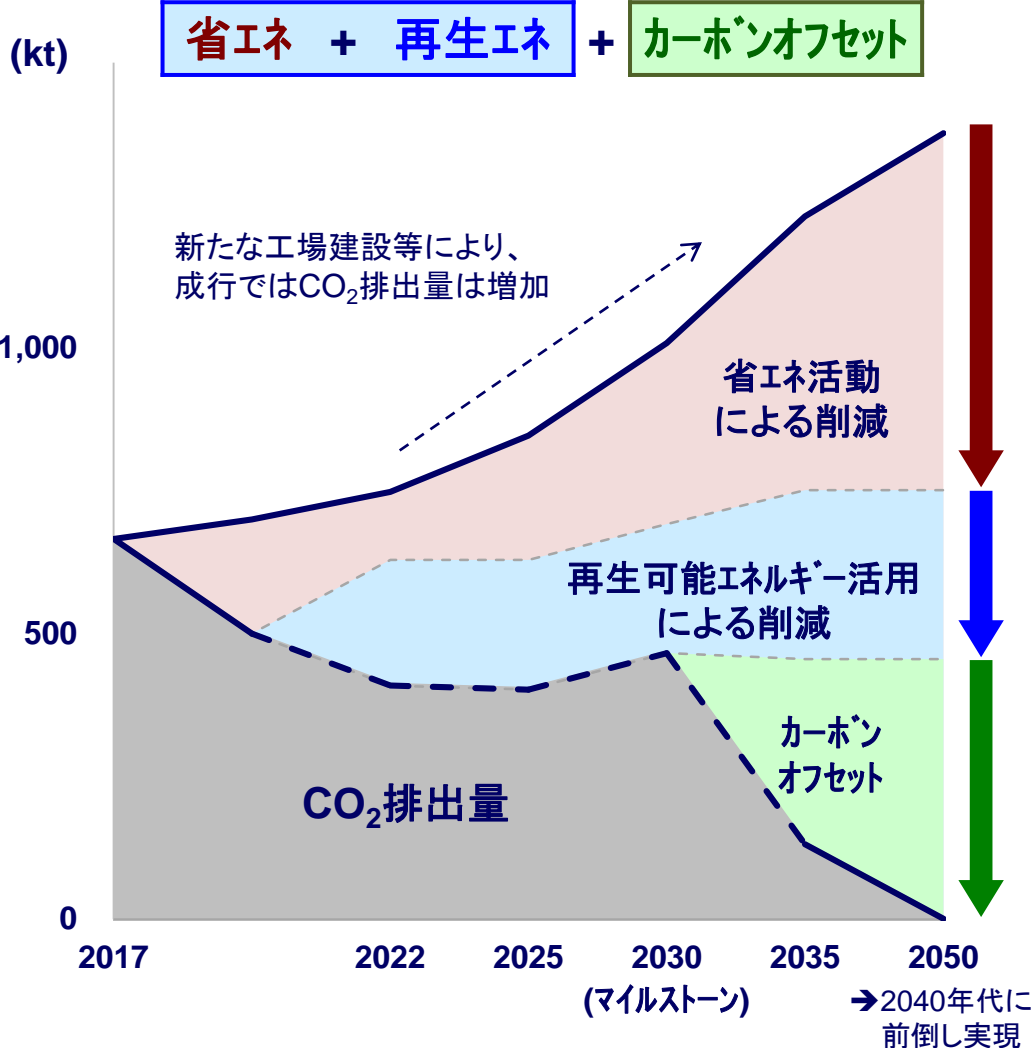
一株当たり配当金



脱炭素社会への 取り組み

脱炭素社会への取り組み

国内外生産拠点のCO₂ゼロ化を
2040年代早期に実現させる



① 省エネルギー活動

- ・3R視点の省エネ推進
- ・設備関連の省エネ・効率UP投資



省エネ技術導入



コージェネレーション

② 再生可能エネルギーの活用

- ・水力/太陽光発電 + 再エネ調達



祖業

水力発電



太陽光発電

③ カーボンオフセットの活動

- ・緑化事業 + 新エネルギー転換(H₂, NH₃)
- ・CO₂回収・固定化の技術開発



化デンの森



全面緑化技術